

Petek, 24. julij 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu smo za vas pripravili izbor novic in aktualnih vsebin, ki vam morda pridejo prav.

Dogodki:

- Konferenca: [ESSERC 2026](#)
7.-10. september 2026, Palma de Mallorca, Španija
ESSERC, vodilni evropski forum za izmenjavo inovacij na področju polprevodniških naprav in vezij, vsako leto organizira evropsko konferenco za predstavitve in razpravo o najnovejših dosežkih na omenjenem področju. Vključena je tudi predstavitev pilotne linije [NanoIC](#). Več informacij in registracija – [tukaj](#).
- Konferenca: [ISIG Executive Summit EU](#), SIGI (International Semiconductor Industry Group)
14.-16. september 2026, Praga, Češka
Srečanje, kjer se bodo vodilni predstavniki polprevodniške industrije sestali na teme umetne inteligence, močnostne elektronike, SiC/GaN tehnologij in elektrifikacije industrije ter izkoristili priložnosti za mreženje in nova partnerstva.
Za vstopnico se prijavite – [tukaj](#).
- Konferenca: [GSCM – Global Semiconductors Conference Malta](#)
16.-17. november, 2026, Malta
Tretja svetovna konferenca o polprevodnikih na Malti z naslovom: »AI and the Great Semiconductor Divide: Strengthening Europe's Competitiveness«
« bo raziskala kritično presečišče umetne inteligence, tehnološkega vodstva in strateške vloge Evrope v tekmi za polprevodnike.
Dogodek bo združil vodilne predstavnike industrije, analitike, inovatorje, oblikovalce politik, zagonska podjetja in investitorje, ki bodo sodelovali v razpravah na visoki ravni o izzivih, priložnostih in strategijah, ki oblikujejo prihodnost polprevodniškega sektorja.
Obravnavane teme bodo:
 - Od laboratorija do tovarne: Izkoriščanje pilotnih linij za industrijsko rast
 - Umetna inteligenca in razkorak v vrednostni verigi – Izogibanje dvohitrostnemu ekosistemu in zagotavljanje široko zastavljenih koristi
 - Kompetenčni centri: Od centrov do vpliva – Perspektive podjetij
 - Izdelano v Evropi in strateška avtonomija – ali bi to poglobilo razkorak ali okrepilo Unijo?
 - Vključenost žensk na področjih polprevodnikov – spodbujanje raznolikosti, inovacij in rasti

- Zmagovalci zagonskih podjetij ChipStart EU Cohort
Celoten program konference na [povezavi](#).

Razpisi:

- Razpis: [HORIZON-Chips-JU-2026-FT2-IA - IA Resilience call reinforcing Europe's strength in photonics](#)

ChipsJU je objavil razpis, ki podpira industrijsko širitev naprednih fotonjskih platform za premostitev vrzeli med raziskavami in proizvodnjo.

Poudarek je na dejavnostih z visoko stopnjo razpoložljivosti tehnologije (TRL), ki utrjujejo položaj Evrope v ključnih delih vrednostne verige fotonike, omogočajo strateško avtonomijo pri kritičnih komponentah in sistemih ter spodbujajo odpornost EU.

Celoten opis razpisa je na voljo v dokumentu na [povezavi](#).

Razpis podpira:

- Skaliranje fotonjskih procesov na ravni rezin za ključne materiale (npr. SiN, InP, GaAs), vključno z integracijo procesov, optimizacijo izkoristka in možnostjo izdelave v velikih količinah.
- Razvoj rešitev za pakiranje in testiranje, ki so skalabilne, avtomatizirane in združljive s sopakirano optiko in napredno fotonjsko-elektronsko integracijo.
- Heterogena integracija materialov in komponent, kot so laserji na čipu, modulatorji in detektorji, z uporabo naprednih pristopov pakiranja in sestavljanja.
- Sootimizacija načrtovanja, procesa in opreme, ki omogoča ponovljivo in stroškovno učinkovito proizvodnjo kompleksnih fotonjskih vezij in sistemov, vključno z uporabo PDK-jev in validiranih gradnikov.
- Demonstracija funkcionalnosti na ravni sistema s primeri uporabe, pomembnimi za aplikacije, v strateških sektorjih (npr. umetna inteligenca, senzorika, telekomunikacije, mobilnost, zdravje, obramba), s kvantificiranimi metrikami učinkovitosti in jasno tržno relevantnostjo.

Okvirni proračun EU: 20 milijonov EUR

Rok za prijavo: 16. september 2026

- Razpis: [DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SG-JAPAN](#) - International collaboration EU and Japan on semiconductors

ChipsJU je objavil razpis za skupne raziskovalno-razvojne projekte med Evropsko unijo in Japonsko.

Razpis je usmerjen v razvoj chiplet tehnologij, heterogene integracije ter integrirane fotonike za prihodnje AI sisteme.

Projekti naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:

- Napredna heterogena integracija, zlasti v 2,5D in 3D pakiranju ter integrirani fotoniki, za podporo funkcionalnostim umetne inteligence.
- Standardizirani vmesniki čipletov, ki omogočajo interoperabilnost in spodbujajo dinamičen ekosistem čipletov.

Okvirni proračun EU: 5 milijonov EUR.

Rok za prijavo je 24. september 2026.

Novice:

- [Nexperia and Semikron Danfoss Explore Strategic Collaboration on SiC Power Modules for Automotive Applications](#)

Nexperia in Semikron Danfoss proučujeta sodelovanje pri razvoju SiC

močnostnih modulov za električna vozila, s ciljem združiti znanje s področja polprevodnikov in močnostnih modulov ter izboljšati učinkovitost in zmogljivost električnih pogonov.

- **ASML Raises Outlook, Plans More EUV Capacity**

Proizvajalec polprevodniške opreme ASML je poročal o dobičku v drugem četrtletju, ki je presegel lastne napovedi, in izboljšal finančne obete za celotno leto.

Velika uspešnost se ujema z novim poročilom industrijskega združenja SEMI, ki napoveduje, da bo svetovna prodaja opreme za proizvodnjo polprevodnikov leta 2026 dosegla rekordnih 165,9 milijarde ameriških dolarjev, kar je 23,2 % več kot leto prej.

Velik del te rasti spodbujajo naložbe v infrastrukturo umetne inteligence, ki zahteva bolj kompleksne zasnove čipov in večje kapitalne izdatke.

- **RISC-V Europe Summit 2026: Beyond Embedded Electronics**

RISC-V Summit Europe 2026, ki je prejšnji mesec potekal v Bologni v Italiji, je združil načrtovalce čipov, razvijalce programske opreme in vesoljske inženirje. Dogodek je pokazal, kako se je arhitektura nabora ukazov RISC-V z odprtimi standardi razširila onkraj specializiranih industrijskih aplikacij in se usmerila v podatkovne centre, robno umetno inteligenco in raziskovanje vesolja.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
ekipa KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Čip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljali na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

